

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年11月21日(21.11.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/236964 A1

(51) 国際特許分類:

H01B 1/20 (2006.01) C08L 63/00 (2006.01)
C08G 59/40 (2006.01) H01B 1/00 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/014649

(22) 国際出願日: 2024年4月11日(11.04.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-079413 2023年5月12日(12.05.2023) JP

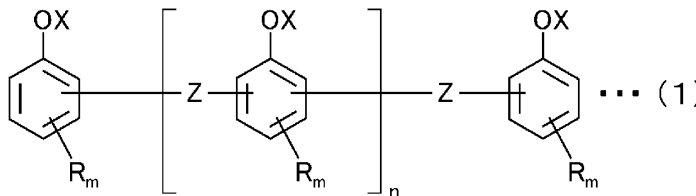
(71) 出願人: 京都エレクトクス株式会社 (KYOTO ELEX CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒6018391 京都府京都市南区吉祥院大河原町1番地 Kyoto (JP).

(72) 発明者: 新井 貴光 (ARAI Takamitsu); 〒6008873 京都府京都市南区吉祥院大河原町1番地 京都エレクトクス株式会社内 Kyoto (JP). 阿部 永嗣 (ABE Hisashi); 〒6008873 京都府京都市南区吉祥院大河原町1番地 京都エレクトクス株式会社内 Kyoto (JP). 留河 悟 (TOMEKAWA Satoru); 〒6008873 京都府京都市南区吉祥院大河原町1番地 京都エレクトクス株式会社内 Kyoto (JP).

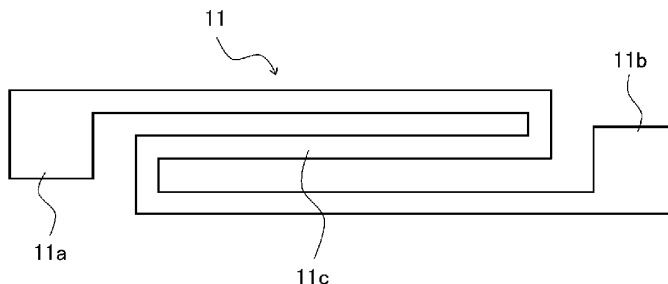
(74) 代理人: 正司 武嗣 (SHOSU Takeshi); 〒6018391 京都府京都市南区吉祥院大河原町5番地 Kyoto (JP).

(54) Title: CONDUCTIVE PASTE COMPOSITION

(54) 発明の名称: 導電性ペースト組成物



[図1]



(57) Abstract: Provided is a conductive paste composition that contains an epoxy resin as a resin component and that is capable of realizing favorable thermal shock resistance and favorable moist heat resistance after curing. The conductive paste composition contains (A) a conductive powder, (B) an epoxy resin which serves as a resin component, (C) a curing agent, and (D) a curing accelerator. The (B) epoxy resin includes at least one type of epoxy resin having an epoxy equivalent of 500 g/eq or more. The (C) curing agent is a phenolic ester compound having a structure represented by formula (1). In the formula, R is a C1 to C10 alkyl group, a phenyl group, an aralkyl group, an alkoxy group, or a halogen atom. In the formula, X is a hydrogen atom or an ester structure represented by -C(=O)-A (where A is a C1 to C6 alkyl group). In

[続葉有]

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

the formula, Z is a C1 to C15 divalent hydrocarbon group. In the formula, m is an integer from 0 to 4, and n is a number having an average value from 0 to 2.

(57) 要約: 硬化後に、良好な耐熱衝撃性と良好な耐湿熱性とを実現可能な、樹脂成分としてエポキシ樹脂を含有する導電性ペースト組成物を提供する。導電性ペースト組成物は、(A) 導電性粉末と、樹脂成分である (B) エポキシ樹脂、(C) 硬化剤、および (D) 硬化促進剤とを含有する。(B) エポキシ樹脂は、エポキシ当量が 500 g/eq 以上のものを少なくとも1種類含有する。(C) 硬化剤は、次式で表される構造を有するフェノール類エステル化合物である。式中Rは、炭素数1~10のアルキル基、フェニル基、アラルキル基、アルコキシル基、ハロゲン原子である。式中Xは水素原子または $-C(=O)-A$ で表されるエステル構造 (Aは炭素数1~6のアルキル基) である。式中Zは炭素数1~15の2価の炭化水素基である。式中mは0~4の整数であり、nは平均値で0~2の数である。